# 猎奇智能（301661.SZ）

## 新股覆盖研究

**投资要点**

◆ 11 月 23 日有一家创业板上市公司“猎奇智能”询价。

◆ 猎奇智能（301661）：公司专注于光通信、半导体及汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。公司 2023-2025 年分别实现营业收入 2.89 亿元/5.43 亿元/6.98 亿元，YOY 依次为 99.47%/87.74%/28.52%；实现归母净利润 0.82 亿元/1.81 亿元/1.82 亿元，YOY 依次为 132.38%/121.53%/0.87%。根据公司预测，2026 年营业收入较 2025 年同期增长 157.96%至 185.12%，归母净利润同比增长 225.06%至 259.28%。

**投资亮点：1、公司是国内光模块封装测试设备的主力供应商之一，在贴片、耦合等细分品类市占率位居行业前列。**公司自成立伊始即深耕光模块智能制造装备领域，现已具备光模块封装全流程设备的开发能力，在贴片设备、耦合设备和老化测试设备等方面成功突破海外垄断，且技术水平比肩国际龙头，为 800G/1.6T 等适配 AI 大模型训练的高速光模块量产提供关键装备支撑。凭借过硬的产品质量及技术创新能力，公司逐步成为国内光模块智能制造装备的主要供应商，与 2025 年光模块全球前十厂商（排名来源于 Light Counting）中九家企业建立了稳定合作关系；同时在市场份额方面，根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司光模块贴片设备以 20%的市占率排名全球第一，光模块耦合设备亦以 23%的市场份额排名全球第二。展望后续，一方面公司订单储备充足，截至 2026 年 6 月末在手订单规模高达 52.26 亿元、超 2025 全年营收的 7 倍；另一方面，公司已前瞻布局激光辅助键合、倒装热压等先进封装相关工艺，以解决未来硅光芯片倒装及 PD 阵列倒装焊接等高端光模块的封装需求，有望持续巩固自身行业竞争地位。**2、全球光模块龙头中际旭创稳定贡献五成以上收入，且拟参与战略配售；“客户+股东”的双重绑定关系，有望为公司后续经营提供稳定支撑。**中际旭创稳居全球光模块龙头；据 Light Counting、弗若斯特沙利文统计，2025 年中际旭创光模块全球市场份额排名第一。公司早在 2015 年成立之初便与中际旭创开启合作，双方拥有十余年稳定协作基础；近年来中际旭创作为公司第一大客户、稳定贡献 50%以上营收，同时公司在中际旭创核心封测设备采购体系中亦占据较高份额。当前，全球 AI 算力需求依旧强劲，中际旭创 2026 年前三季度实现营业收入 695.47 亿元、同比增长 178.13%，并表示 2026-2027 年将在 2800 多万只年化产能基础上继续扩产，有望带动公司收入规模与技术实力提升。此外，中际旭创已参与公司本次 IPO 战略配售，“客户+股东”的双重身份或将进一步深化双方绑定、巩固合作关系。**3、公司利用在光通信领域积累的自动化装备经验及技术，积极将产品应用扩展至半导体、汽车自动化等领域。**（1）依托技术同源，公司持续向半导体领域延伸布局，现已推出适配半导体微波射频领域的固晶和共晶贴片设备，并实现对射频行业知名客户批量供货；而针对 IC 行业单芯片、多芯片、倒装、倒装热压超声等贴装形式，公司则开展 IC 高速固晶机、TCB 设备等新设备的研发，部分产品如 TCB 设备已形成样机在客户处验证，SiC 预烧结设备已通过士兰微验证。（2）汽车自动化领域系公司依托智能装备领域技术积累进行的延伸布局与应用场景拓展；报告期内已与索恩格、苏世博、三花智控等全球头部汽车零部件供应商建立深度

**交易数据**

| | |
|---|---|
| 总市值（百万元） | |
| 流通市值（百万元） | |
| 总股本（百万股） | 55.00 |
| 流通股本（百万股） | |
| 12 个月价格区间 | / |

分析师 李蕙
SAC 执业证书编号：S0910519100001
lihui1@huajinsc.cn
分析师 戴筝筝
SAC 执业证书编号：S0910526030001
daizhengzheng@huajinsc.cn

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（乔路铭）-2026 年 78 期-总第 715 期 2026.7.14
华金证券-新股-新股专题覆盖报告（龙鑫智能）-2026 年 76 期-总第 713 期 2026.7.13
华金证券-新股-新股专题覆盖报告（泰诺麦博）-2026 年 77 期-总第 714 期 2026.7.10
华金证券-新股-新股专题覆盖报告（欧伦电气）-2026 年 75 期-总第 712 期 2026.7.9
华金证券-新股-新股专题覆盖报告（永励精密）-2026 年 73 期-总第 710 期 2026.7.4

合作关系，相关收入已由 2023 年的 0.34 亿元增长至 2025 年的 1.36 亿元。

- **同行业上市公司对比：**根据主营业务的相似性，选取 BESI、ASMPT、致茂电子、新益昌、罗博特科（FiconTEC）、联讯仪器为猎奇智能的同行业可比上市公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 43.99 亿元，平均 PE-TTM 为 45.48X，平均销售毛利率为 47.55%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率未及可比公司平均。

◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

**公司近 3 年收入和利润情况**

| 会计年度 | 2023A | 2024A | 2025A |
|---|---|---|---|
| 主营收入(百万元) | 289.2 | 542.9 | 697.8 |
| 同比增长(%) | 99.47 | 87.74 | 28.52 |
| 营业利润(百万元) | 94.6 | 209.1 | 208.9 |
| 同比增长(%) | 135.49 | 121.06 | -0.09 |
| 归母净利润(百万元) | 81.6 | 180.8 | 182.4 |
| 同比增长(%) | 132.38 | 121.53 | 0.87 |
| 每股收益(元) | | 5.17 | 4.40 |

*数据来源：聚源、华金证券研究所*

# 内容目录

**一、猎奇智能 ..... 4**
（一）基本财务状况 ..... 4
（二）行业情况 ..... 5
（三）公司亮点 ..... 9
（四）募投项目投入 ..... 10
（五）同行业上市公司指标对比 ..... 10
（六）风险提示 ..... 11

# 图表目录

图 1：公司收入规模及增速变化 ..... 4
图 2：公司归母净利润及增速变化 ..... 4
图 3：公司销售毛利率及净利润率变化 ..... 5
图 4：公司 ROE 变化 ..... 5
图 5：全球光模块封测设备市场规模-按速率划分（以价值计/单位：亿元） ..... 6
图 6：全球光模块封测设备市场规模-按产品划分（以价值计/单位：亿元） ..... 6
图 7：全球半导体固晶机市场规模（单位：亿元） ..... 8

表 1：公司 IPO 募投项目概况 ..... 10
表 2：同行业上市公司指标对比 ..... 11

# 一、猎奇智能

公司专注于光通信、半导体及汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售，产品覆盖光模块封装测试的核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等关键工序，相关设备是保障光模块传输效率与可靠性的核心装备，并最终应用于数通市场及电信市场。同时，公司依托光通信领域积累的自动化装备技术优势，积极布局半导体、汽车自动化智能装备领域，持续强化综合竞争实力。

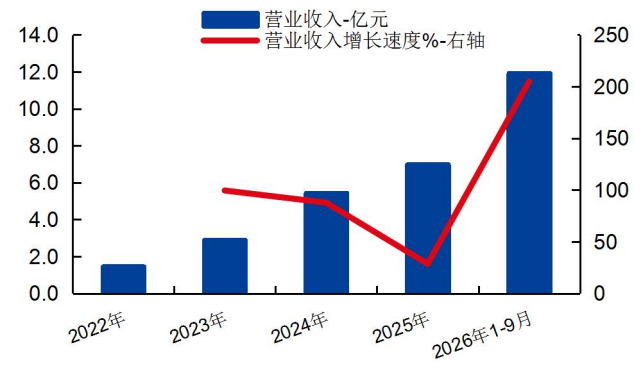
依托多年在运动控制、机器视觉、软件算法、机械设计等领域的深耕积累和自主创新，目前公司已具备光模块封装全流程核心设备的开发能力，并在贴片设备、耦合设备和老化测试设备等方面已经实现了国产化；其中共晶贴片设备的设备精度达到±1μm，产品精度达到±3μm，技术水平与国际龙头齐平，耦合设备、固晶贴片设备性能位居行业前列，助推客户提升工艺及效率，实现智能化生产的目标。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利共 55 项，并以技术诀窍（Know-How）和商业机密的形式保有众多工艺及专有技术。

## （一）基本财务状况

公司 2023-2025 年分别实现营业收入 2.89 亿元/5.43 亿元/6.98 亿元，YOY 依次为 99.47%/87.74%/28.52%；实现归母净利润 0.82 亿元/1.81 亿元/1.82 亿元，YOY 依次为 132.38%/121.53%/0.87%。据最新财报情况，2026 年 1-9 月公司实现营业收入 11.93 亿元，同比增长 204.84%；实现归属于母公司净利润 3.76 亿元，同比增长 332.09%。

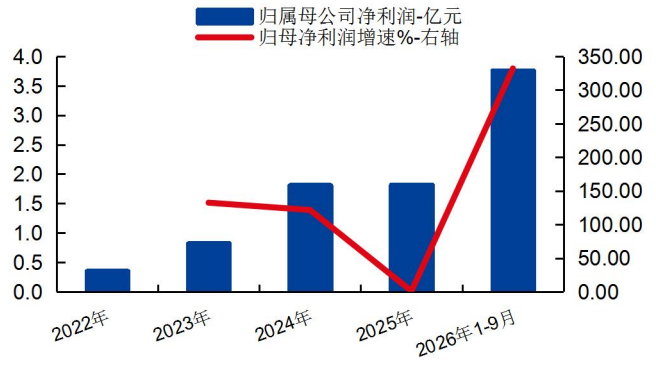
2026 年 1-9 月，公司主营业务收入按产品类别可分为五大板块，分别为耦合设备（5.71 亿元，占 2026 年 1-9 月主营收入的 47.84%）、贴片设备（3.02 亿元，占 2026 年 1-9 月主营收入的 25.32%）、老化测试设备（1.81 亿元，占 2026 年 1-9 月主营收入的 15.13%）、自动化设备及整线解决方案（0.42 亿元，占 2026 年 1-9 月主营收入的 3.55%）、配件及其他（0.97 亿元，占 2026 年 1-9 月主营收入的 8.13%）。2023 年至 2026Q3，耦合设备与贴片设备始终为公司主要收入来源，合计收入占比稳定在 55%；其中耦合设备收入呈逐年增长态势，最新报告期收入占比已接近五成。

图 1：公司收入规模及增速变化



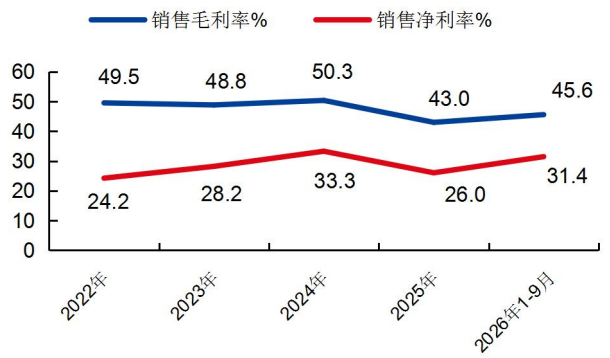

资料来源：iFind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



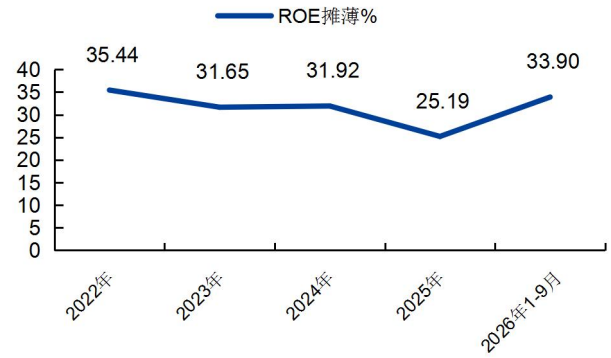

资料来源：iFind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利润率变化




资料来源：iFind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化




资料来源：iFind，华金证券研究所

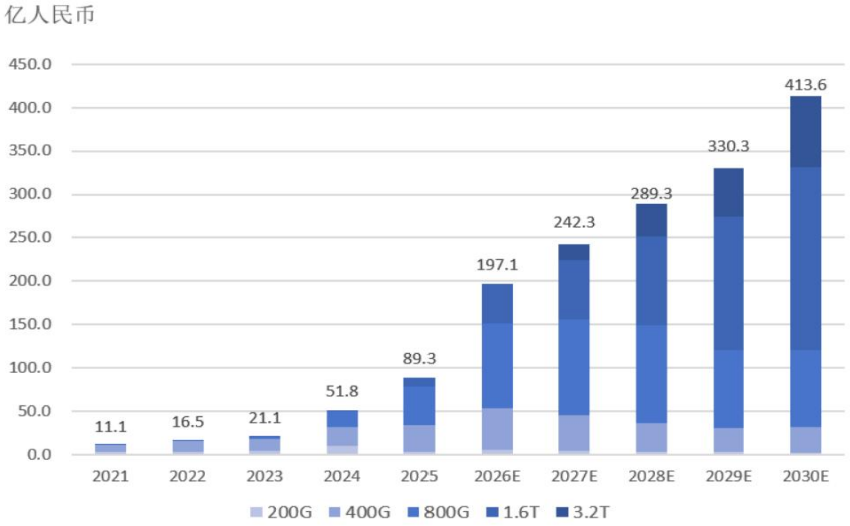
## （二）行业情况

### 1、光模块封测设备行业

公司所处细分行业为光模块封装设备行业，位于光模块产业链上游，是支撑光模块制造的关键环节。作为保障光通信设备质量与可靠性的核心载体，光模块封装测试工艺复杂且流程精密，涵盖贴片、引线键合、光学耦合、封装及老化测试等多个关键环节，涉及固晶贴片机、共晶机、光耦合机、芯片/模块老化测试设备等专业装备。公司产品主要应用于贴片、光学耦合、老化测试三大核心制造环节，其中贴片机作为单台设备价值量最高的环节，直接决定光芯片与电芯片的贴装精度（影响模块性能的关键参数）。随着 400G、800G 及 1.6T 高速率光模块的规模化应用，其对高精度贴片机、耦合设备及智能化老化测试系统的需求持续增长，推动行业高端设备市场快速扩容。

受益于 AI 算力需求爆发，全球高速率光模块封测设备市场呈现跨越式增长。据弗若斯特沙利文数据，全球市场规模从 2021 年 11.1 亿元增至 2025 年 89.3 亿元，年复合增长率达 68.42%，其中 800G 光模块设备市场规模从 2022 年 0.1 亿元激增到 2025 年 43.6 亿元，成为增长最快的细分领域。预计在 AI 服务器扩产驱动下，800G 和 1.6T 光模块设备需求持续提升，2026 年 800G 和 1.6T 光模块封测设备市场规模分别有望达 98.5 亿元及 45.3 亿元，而 2030 年全球高速率光模块封装设备市场规模有望突破 413.6 亿元，2026-2030 年复合增长率 20.5%。

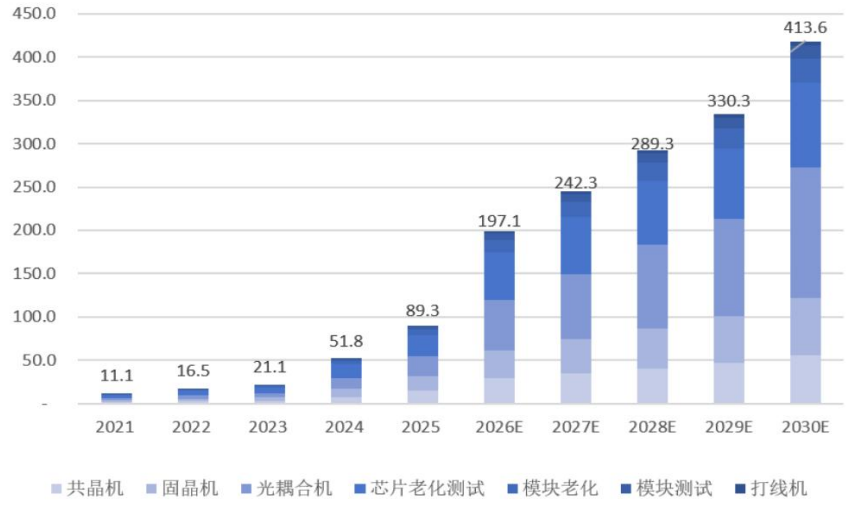
图 5：全球光模块封测设备市场规模-按速率划分（以价值计/单位：亿元）




*资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所*

光模块封测设备中，固晶贴片机、共晶机、光耦合机是最核心的设备，单价也相对较高。受人工智能、大数据、云计算产业拉动，光模块封测设备需求快速增加，其中固晶机全球市场规模在 2025 年达到 16.6 亿人民币，预计其市场规模在 2030 年达 66.0 亿人民币，2026 年到 2030 年复合增长率为 19.2%。全球光耦合机全球市场规模在 2025 年达到 23.1 亿人民币，预计 2030 年全球市场规模为 150.8 亿元人民币。芯片老化测试设备是光模块封测设备中价值占比最高的设备，2025 年其全球市场规模为 24.9 亿人民币，占高端光模块封测设备总市场的 27.9%。

图 6：全球光模块封测设备市场规模-按产品划分（以价值计/单位：亿元）




*资料来源：弗若斯特沙利文，华金证券研究所*

随着云计算、数据中心及 5G 通信网络的爆发式增长，光模块正加速向 800G/1.6T 及以上超高速率迭代。2025 年 1.6T 产品已进入谷歌、Meta 等头部企业的预商用测试阶段。光模块封测设备行业展现出三大趋势：

一是高精度与高速率制造设备成为核心。为满足光模块中光电共封装的亚微米级贴装要求，设备厂商通过高刚性运动平台、多轴联动视觉系统和热膨胀补偿算法实现精度跃升。部分国产厂商的贴片机加工精度已达±3μm，支持多芯片贴装；耦合设备已能达到最小运动增量 50nm；高

速率方面，通过优化贴装系统轨迹曲线&降低工艺消耗时间（如共晶提升升降温速率）。从而满足日益增长的需求。

二是集成化整线交付与智能化生产加速渗透。当前光模块封测设备行业正加速迭代，核心呈现两大发展方向，既适配高速光模块技术升级需求，也响应下游客户生产效率提升诉求。一方面，在 800G/1.6T 光模块的规模化生产中，由于硅光技术的高速率、低功耗等优点，未来高速率光模块将采用硅光芯片，光模块封测设备需兼容硅光、CPO 光电共封测等复杂封测工艺，并通过多工艺平台整合提升功能密度。与此同时，下游客户对生产效率的需求持续升级，行业正从“孤立设备供应”向“整线交付方案”转型。客户不再满足于单独采购设备，更需要覆盖“工艺设计-设备部署-生产运维”全流程的一体化方案，以此降低不同设备间的整合成本，提升产线整体协同效率，适配高速光模块大规模量产的节奏。另一方面，智能化成为提升封测设备核心竞争力的关键方向之一。随着智能化控制技术逐步普及，如贴片机通过基于 PID 补偿算法，提升设备精度稳定性。并集成 MES 与 AGV 上下料系统，做到设备信息互联，物料智能调度。且智能化程度从单站向多站衍进，并最终迈向整厂智能化。

三是设备国产化率持续提升。在政策支持与市场需求双重驱动下，国产光模块封测设备正快速突破“卡脖子”环节。一方面，国内厂商通过自主创新补足高端设备短板。另一方面，产业链协同效应显现，全球前十大光模块厂商中七家为中国企业，带动生产设备国产化率不断提升，同时也可以保护产业链稳定，防止国际政治对于供应链上游可能出现的影响。随着 3D 先进封装需求增长，国产设备厂商有望在贴片、光耦合等领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

**2、半导体封装设备行业**

半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制造的性能、效率及良率，所以半导体设备具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、客户验证壁垒高等特点。在半导体产业链中，封装测试处于晶圆制造过程中的后道环节，在芯片制造完后，将晶圆进行封装测试。封装的作用包含对芯片的支撑与机械保护、电信号的互连与引出、电源的分配、热管理、功能集成及系统测试等。

半导体封装设备是确保芯片功能与可靠性的关键环节，涵盖从晶圆切割到成品测试的全流程。目前，典型封装流程包括划片-减薄-固晶-键合-塑封-切筋成型-测试，相对应的设备则主要为：划片机（切割晶圆）、固晶机/贴片机（芯片贴装）、引线键合机（电气连接）、塑封机（封装保护）、测试机（性能验证）。

全球封测市场规模稳定增长，先进封装贡献主要增量。未来汽车电子、人工智能、数据中心等应用领域的快速发展将推动全球封测市场持续高走。而在半导体封测设备市场规模方面，根据 SEMI 及东吴证券的测算数据，2021 年全球封装设备规模达到 490 亿元，2022 年和 2023 年受传统封装市场逐渐饱和的影响，市场规模有所回落。但 2024 年随着 AI、新能源、光伏等新兴行业的需求扩大，先进封装需求的上升将带动市场进入稳步回升期。根据 SEMI 预测，2024 年全球半导体封装设备市场规模有望达 59.5 亿美元，折合人民币约 430.8 亿元。而根据 SEMI 及公司招股书显示，贴片机在全球半导体封装设备中的价值占比约为 32%，预计 2025 年全球市场规模约 133 亿元人民币。

图 7：全球半导体固晶机市场规模（单位：亿元）




*资料来源：SEMI，公司招股书，华金证券研究所*

随着全球半导体市场对高性能、高密度芯片需求的增加，半导体封装设备市场规模正在迅速扩大。特别是在 5G 通信、人工智能、物联网、自动驾驶等新兴技术的推动下，对更小尺寸、更高集成度和更好性能的先进封装解决方案的需求愈发强烈。这促进了如倒装芯片（Flip Chip）、晶圆级封装（WLP）、硅通孔（TSV）等技术的发展，并带动了相关先进封装设备市场的增长。面对这一趋势，封装设备制造商不断加大研发投入，开发支持新技术的设备，以保持竞争力。同时，封装工艺复杂性的增加对设备精度和效率提出了更高的要求，为高端封装设备提供了广阔的应用前景。

同时国内方面，近年来半导体封装设备领域的国产化率显著提升，为本土企业带来了新的发展机遇。随着国家政策的支持和一系列扶持措施的出台，本土企业在技术研发上的投入不断增加，取得了重要突破。国际贸易形势的变化也促使更多国内企业重视供应链的安全性和自主性，倾向于采购国产设备，这为本土企业创造了有利的市场环境。

**3、自动化设备行业**

自动化设备商核心服务于终端用户及细分市场，基于客户特定应用场景与工艺需求，提供定制化系统集成与软件开发服务。行业以非标准化产品为主要业务形态，需结合场景特性进行定制化设计，因此要求企业具备深厚的产品设计能力、丰富项目经验及精准的工艺需求理解，进而提供覆盖多领域的标准化与个性化智能装备解决方案。

公司自动化设备及整线解决方案业务的核心下游领域为汽车制造业及光通信行业，主要服务于汽车零部件厂商及光模块厂商的自动化生产流程。下游行业的产品需求直接决定市场需求强度，其快速增长将有效拉动行业市场容量扩张，形成显著的需求传导效应。

我国汽车制造业呈现稳健增长态势，为自动化设备行业提供广阔市场空间。根据中国汽车工业协会数据，2019-2024 年我国汽车销量年均复合增长率达 4.06%，尽管 2020 年短期承压，但随着新能源汽车渗透率快速提升，市场逐步释放增长动能，带动整体汽车销量稳步回升。据中国汽车工业协会预测，2025 年中国汽车总销量将达到 3,290 万辆，同比增长 4.7%。汽车零部件制造作为产业链关键环节，其规模扩张与汽车产销量呈强正相关。我国汽车零部件行业销售规模由 2019 年 3.57 万亿元增至 2024 年 4.6 万亿元，复合增长率 5.26%；另据国家统计局、弗若斯特沙利文预测数据显示，预计 2029 年中国乘用车零部件制造业营业收入达到 5.2 万亿元。长期来

看，汽车电动化、智能化趋势持续深化，零部件制造的精密化、自动化需求同步提升，为自动化设备行业创造持续增长空间。

## （三）公司亮点

**1、公司是国内光模块封装测试设备的主力供应商之一，在贴片、耦合等细分品类市占率位居行业前列。**长期以来，光通讯封装设备市场主要由欧美厂商主导，高端光模块封测设备的国产化率尚不足 20%，国内设备厂商拥有广阔的国产化空间。公司自成立伊始即深耕光模块智能制造装备领域，现已具备光模块封装全流程设备的开发能力，并在贴片设备、耦合设备和老化测试设备等方面成功突破海外技术垄断；其中，代表性产品共晶贴片设备被江苏省工业和信息化厅评为首台（套）重大装备，其设备精度达±1μm、产品精度达±3μm，技术水平比肩 BESI、ASMPT 等国际龙头，为 800G/1.6T 等适配 AI 大模型训练的高速光模块量产提供关键装备支撑，助力国内光通信产业链自主可控。凭借过硬的产品质量及技术创新能力，公司逐步成为国内光模块智能制造装备的主要供应商，与 2025 年光模块全球前十厂商（前十厂商排名来源于 Light Counting）中九家企业建立了稳定合作关系；同时在市场份额方面，根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司光模块贴片设备以 20%（按设备数量口径统计）的市占率排名全球第一，光模块耦合设备亦以 23%的市场份额排名全球第二。展望后续，一方面公司订单储备充足，截至 2026 年 6 月末在手订单规模高达 52.26 亿元、超 2025 全年营收的 7 倍；另一方面，公司已前瞻布局激光辅助键合、倒装热压等先进封装相关工艺，以解决未来硅光芯片倒装及 PD 阵列倒装焊接等高端光模块的封装需求，有望持续巩固自身行业竞争地位。

**2、全球光模块龙头中际旭创稳定贡献五成以上收入，且拟参与战略配售；“客户+股东”的双重绑定关系，有望为公司后续经营提供稳定支撑。**中际旭创稳居全球光模块龙头；据 Light Counting、弗若斯特沙利文统计，2025 年中际旭创光模块全球市场份额排名第一，其中 800G 及以上光模块市场份额超过 40%。公司早在 2015 年成立之初便与中际旭创开启合作，双方拥有十余年稳定协作基础；近年来中际旭创作为公司第一大客户、稳定贡献 50%以上营收，同时公司在中际旭创核心封测设备采购体系中亦占据较高份额，双方合作关系紧密。当前全球 AI 算力需求依然强劲，云服务厂商持续加大数据中心及算力基础设施投入，拉动高速光模块需求上行；2026 年前三季度，中际旭创实现营业收入 695.47 亿元、同比增长 178.13%，延续高增态势，并表示 2026-2027 年将在 2800 多万只年化产能基础上继续扩产；公司作为中际旭创产能扩张有力的设备保障，中际旭创业务的较快发展亦有望带动公司收入规模与技术实力提升，形成上下游协同发展、互利共赢的良好格局。此外，据招股书披露，中际旭创拟参与公司本次 IPO 战略配售，“客户+股东”的双重身份或将进一步深化双方绑定、巩固合作关系。

**3、公司利用在光通信领域积累的自动化装备经验及技术，积极将产品应用扩展至半导体、汽车自动化等领域。**（1）半导体方面，光模块所用光电芯片属于半导体光电子器件范畴，同时半导体其他领域的封装测试工艺流程与光模块领域较为接近，均涉及芯片贴装、键合、测试等环节，两类封测设备在底层原理、技术方面存在一定的共通性。依托技术同源，公司持续向半导体领域延伸布局，现已推出适配半导体微波射频领域的固晶和共晶贴片设备，并实现对射频行业知名客户批量供货；而针对 IC 行业单芯片、多芯片、倒装、倒装热压超声等贴装形式，公司则开展 IC 高速固晶机、TCB 设备等新设备的研发，部分产品如 TCB 设备已形成样机在客户处验证，SiC

预烧结设备已通过士兰微验证。（2）汽车自动化领域系公司依托智能装备领域技术积累进行的延伸布局与应用场景拓展。公司将长期积累的运动控制、机器视觉、机械设备等核心技术复用至汽车自动化装备的研发与制造；报告期内已与索恩格、苏世博、三花智控等全球头部汽车零部件供应商建立深度合作关系，相关收入已由 2023 年的 0.34 亿元增长至 2025 年的 1.36 亿元，体现公司在汽车自动化等领域的市场拓展能力和业绩成长性。

## （四）募投项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 2 个项目，以及补充流动资金。

**1、高端智能装备制造建设项目：**公司计划新建智能化生产线，项目建筑面积 56,000.00 平方米，并引入先进的生产设备，扩大公司现有产能，以满足光通信、半导体和汽车产业等下游市场对智能生产装备持续增长的需求。根据公司预测，项目建成投产后，项目达产年营业收入 15.11 亿元。

**2、研发中心建设项目：**公司计划新建研发中心，建立功能完善的研究实验室，购置先进的研发、试验设备和软件，并通过引进机械、光学、软件等领域的高端研发人才以扩充公司技术研发团队；同时还将开展前瞻性技术研发，向半导体领域封装设备进行技术延伸。

表 1：公司 IPO 募投项目概况

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟募集资金投资额（万元） | 项目投资期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高端智能装备制造建设项目 | 58,240.78 | 58,240.78 | 3 年 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 25,100.61 | 25,100.61 | 3 年 |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | - |
| | **总计** | **91,341.39** | **91,341.39** | **-** |

*资料来源：公司招股书，华金证券研究所*

## （五）同行业上市公司指标对比

2025 年度，公司实现营业收入 6.98 亿元，同比增长 28.52%；实现归属于母公司净利润 1.82 亿元，同比增长 0.87%。根据管理层初步预测，公司预计 2026 年实现营业收入 18.00 亿元至 19.90 亿元，较 2025 年同比增长 157.96%至 185.12%；预计实现归母净利润 5.93 亿元至 6.55 亿元，较 2025 年同比增长 225.06%至 259.28%；预计实现扣非归母净利润 5.82 亿元至 6.44 亿元，较 2025 年同比增长 239.78%至 275.55%。

公司专注于智能生产装备领域；根据主营业务的相似性，选取 BESI、ASMPT、致茂电子、新益昌、罗博特科（FiconTEC）、联讯仪器为猎奇智能的同行业可比上市公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 43.99 亿元，平均 PE-TTM（剔除异常值及负值/算术平均）为 45.48X，平均销售毛利率为 47.55%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率未及可比公司平均。

表 2：同行业上市公司指标对比

| 代码 | 简称 | 总市值(亿元) | PE-TTM | 2025 年营业收入(亿元) | 2025 年营收增速 | 2025 年归母净利润（亿元） | 2025 年归母净利润增速 | 2025 年销售毛利率 | 2025 年 ROE（摊薄） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESI.AS | BESI | 873.26 | 92.54 | 48.70 | -2.70% | 10.84 | -27.70% | 63.29% | 28.69% |
| 0522.HK | ASMPT | 324.69 | 18.26 | 123.42 | 3.83% | 8.10 | 161.26% | 37.75% | 5.30% |
| 2360.TW | 致茂电子 | 983.87 | 26.85 | 63.11 | 31.05% | 26.06 | 122.10% | 61.55% | 41.19% |
| 688383.SH | 新益昌 | 70.99 | -106.99 | 7.27 | -22.17% | -1.27 | -414.39% | 29.34% | -10.31% |
| 300757.SZ | 罗博特科（FiconTEC） | 385.13 | 566.97 | 9.50 | -14.14% | -0.66 | -204.00% | 34.52% | -3.97% |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 922.32 | 44.28 | 11.94 | 51.41% | 1.74 | 23.60% | 58.84% | 19.35% |
| 平均值 | | 592.67 | 45.48 | 43.99 | 7.88% | 7.47 | -56.52% | 47.55% | 13.38% |
| **301661.SZ** | **猎奇智能** | **/** | **/** | **6.98** | **28.52%** | **1.82** | **0.87%** | **42.96%** | **25.19%** |

*资料来源：iFind（数据截至日期：2026 年 11 月 17 日），华金证券研究所*

*备注：可比公司 PE-TTM 均值计算剔除新益昌、罗博特科。*

## （六）风险提示

单一客户重大依赖风险、经营业绩波动或下滑的风险、未能紧跟光模块技术迭代升级的风险、产品质量风险、技术泄密风险、国际贸易摩擦风险、光模块行业周期波动导致下游客户资本性支出减少的风险、市场竞争加剧的风险、应收账款及合同资产出现坏账损失的风险、毛利率下滑的风险、存货余额较高及跌价风险、实际控制人不当控制风险等。

**投资评级说明**

公司投资评级：

买入 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的） 或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

**分析师声明**

李蕙、戴筝筝声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

**本公司具备证券投资咨询业务资格的说明**

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

**免责声明：**

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

**风险提示：**

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司
办公地址：
上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层
北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层
深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元
电话：021-20655588
网址： www.huajinsc.cn